**Premier Farnell liefert ab sofort das neue Raspberry Pi Compute Module 3+**

*Das weiterentwickelte Compute Module verfügt über die verbesserte Wärmeleistung des Raspberry Pi 3 Model B+ bei kleinerem Formfaktor mit vier Speichervarianten und größerem Betriebstemperaturbereich*

**Leeds, Vereinigtes Königreich, 28. Januar 2019:** [Premier Farnell](https://www.premierfarnell.com/), der Development Distributor, bietet das neue Raspberry Pi Compute Module 3+ ab sofort für den Versand am gleichen Werktag an. Das Raspberry Pi Compute Module 3+ verfügt über die gleiche verbesserte Wärmeleistung und Benutzerfreundlichkeit wie das Raspberry Pi 3 Model B+ bei kompakterem Formfaktor. Hinzu kommen verschiedene Speichervarianten, die sich für eine Reihe von Embedded-Anwendungen eignen, darunter IoT-Geräte sowie industrielle Automatisierungs-, Überwachungs- und Steuerungssysteme.

Das Raspberry Pi Compute Module 3+ basiert auf dem 64-Bit-Anwendungsprozessor der Baureihe BCM2837B0 von Broadcom mit 1,2 GHz sowie einem 1-GB-LPDDR2-SDRAM. Entwickler haben die Wahl zwischen eMMC-Flash-Speichervarianten mit 8 GB, 16 GB oder 32 GB sowie einer „Lite“-Ausführung ohne eMMC-Flash, sodass verschiedene Speicheranforderungen erfüllt werden.

„Unsere Kunden betonen immer wieder, dass es die einfache Handhabung des Raspberry Pi ist, die ihn so attraktiv macht. Über ein Drittel\* unserer Raspberry-Pi-Kunden verwenden diese Platine in professionellen Anwendungsbereichen“, **so Hari Kalyanaraman, Global Head of SBC and Emerging Business bei Premier Farnell und Farnell element14**. „Diese neue Version des beliebten Raspberry Pi Compute Module überzeugt durch einfache Bedienung, bessere Wärmeleistung sowie höhere Flexibilität dank verschiedener Speichervarianten. Entwickler müssen ihre Platine nicht mehr anpassen, wenn sie zusätzlichen Speicher benötigen, und können ihre Produkte schneller als je zuvor auf den Markt bringen.“

**Eben Upton, CEO der Raspberry Pi Trading, ergänzt:** „Mit der heutigen Markteinführung des Raspberry Pi Compute Module 3+ sind wir in der Lage, ein umfassendes Sortiment an Einplatinencomputer- und System-on-Module-Produkten anzubieten, die auf dem neuesten Hochleistungsbaustein der Baureihe BCM2837B0 von Broadcom aufbauen. Das Compute Module 3+ ist sowohl für Maker als auch für professionelle Entwickler geeignet und bietet neben einer verbesserten Wärmeleistung einen größeren unterstützten Umgebungstemperaturbereich, mehr Speicheroptionen sowie Zugang zum weltweit führenden Community- und Software-Ökosystem von Raspberry Pi.“

Hier eine Übersicht der wichtigsten Eigenschaften des Raspberry Pi Compute Module 3+:

* Prozessor: SoC der Baureihe BCM2837B0 von Broadcom, mit Quad-Core-Cortex-A53-Prozessor mit 64 Bit bei 1,2 GHz.
* Multimedia: H.264- und MPEG-4-Decoder (1080p30); H.264-Encoder (1080p30); OpenGL ES, 2.0 Grafik.
* Unterstützung für SD-Karten: Mit CM3+/Lite können die Modulpins als SD-Kartenschnittstelle genutzt werden, damit Benutzer entweder ein externes eMMC-Gerät anschließen oder eine SD-Karte einstecken können.
* Unterstützt einen Umgebungstemperaturbereich von -20 bis +70 °C.

Das Raspberry Pi Compute Module 3+ wird noch bis mindestens Januar 2024 produziert.

Das Raspberry Pi Compute Module 3+ ist als eigenständige Platine oder als Development Kit mit einer Raspberry Pi Compute Module I/O-Platine, einem Raspberry Pi CM3+/32-GB-Modul, Raspberry Pi CM3+/Lite-Modul, einem Display und Kameraadaptern erhältlich. Besuchen Sie die Website von [Farnell element14](http://de.farnell.com/buy-raspberry-pi)in Europa, [element14](http://sg.element14.com/buy-raspberry-pi) im Asien-Pazifik-Raum oder [Newark element14](http://www.newark.com/buy-raspberry-pi)in Nordamerika.

**\*\* Ende \*\***

**Anmerkungen für Redakteure**

\*Basierend auf Umfragen von Premier Farnell

Sie finden weitere Details und Bildmaterial zu dieser Pressemitteilung in unserem Newsroom: [www.element14.com/news](http://www.element14.com/news)

**Über uns**

[Farnell element14](http://de.farnell.com) gehört zur [Premier Farnell](http://www.premierfarnell.com/) -Unternehmensgruppe, einem weltweiten Technologieführer mit über 80 Jahren Erfahrung im High-Service-Vertrieb von Technologieprodukten und Lösungen für die Konzeption, Fertigung, Wartung und Reparatur von elektronischen Systemen. Als marktführender Development Distributor nutzt Premier Farnell diese Erfahrungen, um seine breite Kundenbasis, von Bastlern bis hin zu Ingenieuren, Wartungstechnikern und Einkäufern, zu unterstützen. Durch die Zusammenarbeit mit führenden Markenherstellern und Start-ups entwickelt Premier Farnell neue Lösungen für die Industrie und unterstützt so die nächste Generation von Ingenieuren.

Premier Farnell ist eine Geschäftsbereich von Avnet (Nasdaq:[AVT](https://ir.avnet.com/)). Premier Farnell firmiert in Europa unter  [Farnell element14](http://farnell.com/) , in Nordamerika unter [Newark element14](http://www.newark.com/)  und im Asien-Pazifik-Raum unter [element14](http://sg.element14.com/) . Die Premier Farnell Group wird von einer globalen Lieferkette von mehr als 3.500 Lieferanten unterstützt und verfügt über ein umfassendes Inventarprofil, das entwickelt wurde, um die Bedürfnisse innovativer Kunden überall zu antizipieren und zu erfüllen. Premier Farnell verkauft seine Produkte direkt an die Verbraucher über ein Netzwerk von Wiederverkäufern und sein [CPC](http://cpc.farnell.com/)-Geschäft in Großbritannien.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter <http://www.premierfarnell.com>

**PR-Agentur für Europa:**

**Chloe Willcox**

**Napier Partnership**

Tel.: +44 1243 531123

E-Mail: [chloe@napierb2b.com](mailto:chloe@napierb2b.com)

[www.napierb2b.com](http://www.napierb2b.com)

**Premier Farnell:**

**Holly Smart**

**Head of PR and External Communications**

Tel.: +44 113 2485188

E-Mail:[hsmart@premierfarnell.com](mailto:hsmart@premierfarnell.com)